

平成14年度
営業報告

第84期

（平成14年4月 1 日から
平成15年3月31日まで）



目 次

会社の概要	3
株主の皆様へ	4
トピックス	6
連結営業の概況	8
連結決算	12
単独決算	18
株式の状況	24
ネットワーク	26
株主メモ	27

グループ経営重視の観点から、本年度より
連結のデータを中心にご報告申し上げます。

表紙の写真

2003環境フォトコンテスト
(プレジデント社主催)
日立ハイテクノロジーズ賞優秀賞受賞作品
「 捕まえたよ!! 」 美藤 明氏撮影



印刷インキは大豆油インキを
使用しております。
*このSOY INKマークは米国
大豆協会承認マークです。

会社の概要

商 号	株式会社 日立ハイテクノロジーズ
本店所在地	東京都港区西新橋一丁目24番14号
設立年月日	昭和22年4月12日
資 本 金	7,938,480,525円(平成15年3月31日現在)
従 業 員	(平成15年3月31日現在) 【連結】8,073名 【単独】3,036名
役 員	(平成15年6月24日現在)
取締役会長 代表執行役	桑田 芳郎
代表執行役 執行役社長 兼取締役	林 将章
代表執行役 執行役専務 兼取締役	角田 雄一
取締役	実松 俊弘
取締役	紀国 郁夫
社外取締役	松香 茂道
社外取締役	石橋 正
執行役常務	山下 勝治
執行役常務	中野 和助
執行役常務	大林 秀仁
執行役常務	宮内 真澄
執行役常務	金内 寛
執行役常務	桜木 雅夫
執行役	西村 康彦
執行役	稲垣 昭久
執行役	三澤 寛
執行役	添田 信弘
執行役	飯塚 茂
執行役	紅林 實
執行役	川崎 義直
執行役	増山 正穂
執行役	林 充宏



株主の皆様には、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃の株主の皆様からのご支援とご理解に對しまして深く感謝申し上げますと共に、平成14年度(第84期)営業報告をお届けするにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

当年度の経営環境は、米国のITバブル崩壊に端を発した景気減速により、「世界同時不況」という厳しい状況下にありました。特に日本国内においては、需給バランスの崩壊により経済のデフレスパイラルが強まるなど、非常に厳しい市場環境の中で推移致しました。

このような環境の中、半導体分野の設備投資抑制の影響を受け半導体製造装置は苦戦したものの、DNAシーケンサやプロテオーム関連製品等ライフサイエンス部門の業績は好調に推移しました。その結果、当年度(平成14年4月～平成15年3月)の連結業績は、売上高778,229百万円(前年度比5.4%増)、経常利益12,104百万円(同17.3%増)、当期純利益5,928百万円(同7.6%増)となりました。

当社の基本方針は、従来と同様「開発と堅実経営により、ナノテクノロジー事業での世界トップ企業を目指す」こととあります。そのために、本年度は特に次の三点に注力して参ります。

第一に、「コア事業リソース集中による経営体質の強化」です。代表的な案件と致しまして、半導体製造装置におきましては、アプリケーション技術部を新設し、ソリューション提案力を強化して参ります。また、バイオ事業では遺伝子情報の診断・創薬への適用拡大に対応するため、DNAシーケンサの生産体制の強化や液体クロマトグラフへのリソース集中により、基盤ビジネスを強化致します。

第二に、「新製品・新規顧客の開発および投資事業の早期黒字化」です。特に、昨年7月に発表致しました次世代光学式外觀検査装置の立ち上げを図ると共に、重要顧客への深耕や新規顧客の開拓に注力致します。また、投資事業に関しましては、案件毎のフォローアップを徹底し、早期の黒字化に向けて取り組んで参ります。特に、チップマウント事業に関しましては三洋電機からの買収に伴い、本年4月より製造・販売・サービスの一貫体制がスタート致しました。本事業は初年度より黒字予算でスタート致しますが、新製品の新規投入と中国などの成長市場への注力により、一層の業容拡大を図ります。

第三に、「グローバル事業の拡大と中国ビジネスの強化」です。平成15年度の業績予想では海外売上高は全体の約52%の規模を計画しており、更なる海外事業の拡大を図って参ります。その中でも、今後特に大きな成長が期待できる地域として、台湾も含めた中国地域での事業拡大に注力し、その売上高は全体に占める比率10%の達成に向けて取り組んで参ります。そのために、中国現地法人であります

上海日立ハイテクノロジーズに中国全土の取り纏め機能を持たせ、製・販・サー体の事業運営体制の構築を図って参ります。

さて、当社は財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主各位に対する適正な利益の還元を利益配分の基本方針とし、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的な配当に努めております。当期末の配当につきましては、厳しい経営環境下ではありますが、業績予想を達成したことを考慮し、1株当たり配当金は業績予想時と同じく7円50銭とすることが決議されました。これにより、当期の配当金につきましては、既の実施した中間配当1株当たり7円50銭と合わせ、年間15円00銭の配当と致しました。

なお、平成15年7月1日には、当社株式の流通の活性化及び投資家層の拡大を図るために、1単元の株式数を1,000株から100株に変更することを予定しております。

平成15年度におきましても世界的な政情不安、国内での金融機関の不良債権処理の加速化等に伴い、デフレ経済下での企業の優勝劣敗が一段と鮮明化すると考えられます。このように市場環境は依然として厳しい状況が続いておりますが、当社基本方針を着実に実践することにより、平成15年度の増収増益を達成すると共に、今後の更なる飛躍に向けて邁進して参る所存でございます。

今後共、変わらぬご支援とご愛顧を引き続き賜いますよう、心よりお願い申し上げます。

平成15年6月

取締役会長
代表執行役 桑田 芳郎

代表執行役
執行役社長
兼 取締役 林 将章



取締役会長
代表執行役 桑田 芳郎



代表執行役
執行役社長
兼 取締役 林 将章

コーポレートガバナンスの強化

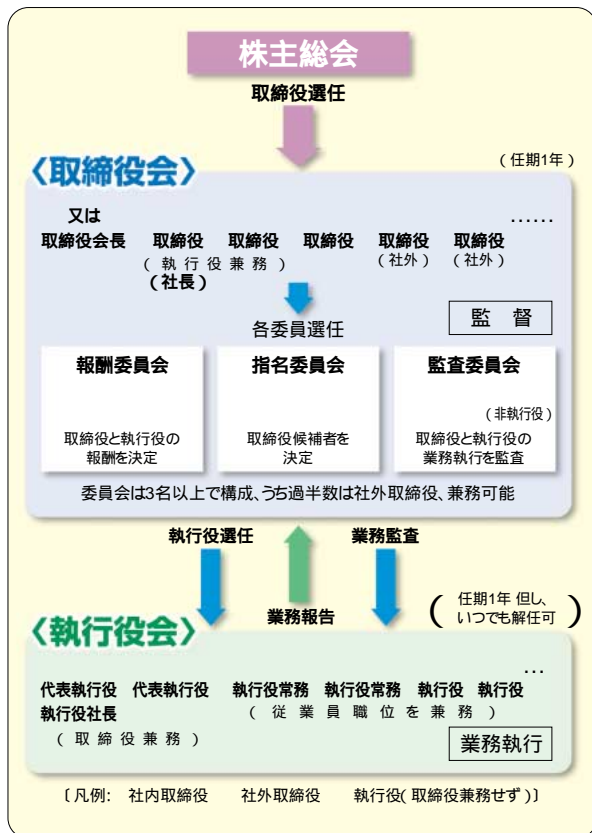
本年4月の商法改正を受け、定時株主総会承認後、委員会等設置会社に移行しました。この目的及び仕組みは、以下のとおりです。

1. 飛躍的な経営スピードのアップ

市場の変化や顧客ニーズに速やかに対応するために、新たに設ける執行役に大幅に業務執行の決定権限を委任し、大胆かつ迅速に業務を推進します。

2. 透明性の高い経営

企業経営で指導的な役割を果たしておられる方を社外取締役として招聘し、当社の経営について客観的な意見をいただくことで、透明性の高い経営に努めます。



チップマウンタ事業会社の移管

平成15年4月1日付で、三洋電機が保有している三洋ハイテクノロジー㈱と三洋ハイテクサービス㈱の全株式を取得し、それぞれ社名を(株)日立ハイテクインスツルメンツ及び(株)日立ハイテクインスツルメンツサービスに変更致しました。この結果、両社が有するチップマウンタ事業の製造・サービス機能と当社の販売機能を統合し、チップマウンタ事業の開発から製造、販売、サービスまでの一貫体制を確立致しました。今後は、スピーディな新技術・新製品の開発や、お客様へのトータル・ソリューションの提供に努め、チップマウンタ事業における世界トップシェアの獲得を目指して参ります。



ヨーロッパ日立ハイテクノロジーズGmbH本社新社屋完成

ヨーロッパの拠点であるヨーロッパ日立ハイテクノロジーズの本社新社屋が、ドイツ デュッセルドルフ市中心地から北西約20kmに位置するクレフェルト市に完成し、平成14年11月に開所式が行われました。本社屋は、日立ハイテク海外グループ会社では初の自社ビルとなります。本社屋にはオフィスやデモセンタ、クリーンルームなどがあるほか、グループ会社の日立計測器サービスの欧州現地法人も入居しており、販売・サービスが一体となった活動を行なっています。



電子デバイスシステム部門

主要取扱品目

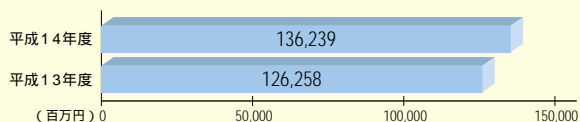
エッチング装置・電子線描画装置・縮小投影露光装置等の半導体製造装置、
測長SEM・外観検査装置等の半導体製造工程検査装置、電子顕微鏡、
液晶関連装置

半導体製造装置については、国内向けに縮小投影露光装置、
米国向けのウェーハ外観検査装置が好調に推移しましたが、
主力の測長SEM・電子線描画装置及びエッチング装置は半導
体投資抑制で伸び悩みました。

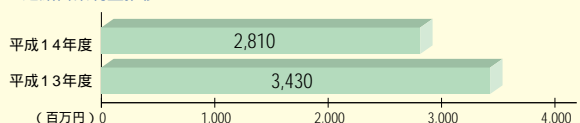
一方、韓国、台湾市場向けの液晶関連装置(日立グループ製
品)は急激に受注拡大しました。

以上の結果、当部門の売上高は136,239百万円(前期比7.9
%増)、営業利益は2,810百万円(同18.1%減)となりました。

連結売上高推移



連結営業利益推移



ウェーハ外観検査装置

ライフサイエンス部門

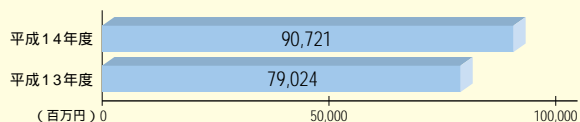
主要取扱品目

質量分析計・核磁気共鳴装置・分光光度計・クロマトグラフ・遠心機等の
各種分析計測機器、バイオ関連機器、医用分析機器

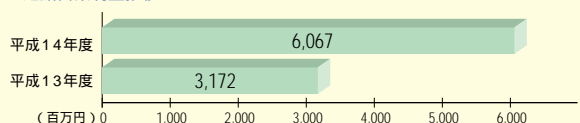
医用分析装置については、国内向け血液自動分析装置が
堅調に推移したほか、NMR(核磁気共鳴装置)等のプロテオーム
関連製品が好調に推移しました。また、米国向けDNAシーケンサ
が好調に推移しました。

以上の結果、当部門の売上高は90,721百万円(前期比14.8
%増)、営業利益は6,067百万円(同91.3%増)となりました。

連結売上高推移



連結営業利益推移



DNAシーケンサ

情報エレクトロニクス部門

主要取扱品目

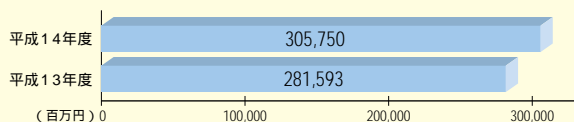
計装機器及び関連システム、燃料電池評価システム、自動組立システム、研究試験設備、コンピュータシステム、プリンタ・磁気記憶装置等の周辺機器、半導体・集積回路、電子デバイス、液晶表示装置、ブロードバンド、民生用情報機器、その他各種電子部品

海外における半導体関連需要が回復基調の中、当部門においても携帯電話用半導体やDVD用光ピックアップが好調に推移したほか、韓国向け携帯電話用リチウムイオン二次電池も堅調に推移しました。

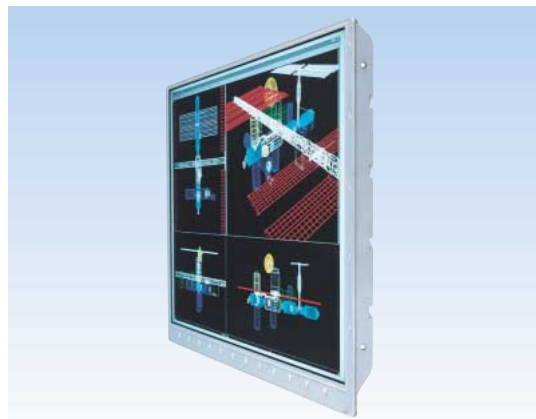
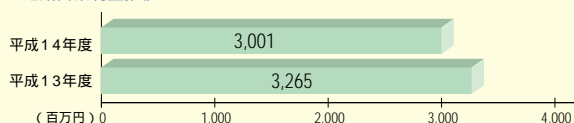
また、カラーテレビ等米国向け情報家電製品も好調に推移しました。

以上の結果、当部門の売上高は305,750百万円(前期比8.6%増)営業利益は3,001百万円(同8.1%減)となりました。

連結売上高推移



連結営業利益推移



液晶表示装置

先端産業部材部門

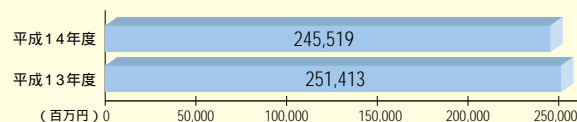
主要取扱品目

鉄鋼製品、非鉄金属製品、基板材料、合成樹脂、電子材料、光通信部材、光ストレージ部材、その他化成品、建設資材

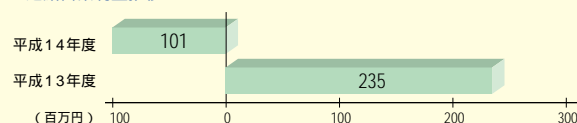
通信業界の低迷により光通信用部品は低調に推移しましたが、液晶プロジェクター用光学部品及び液晶関連材料が堅調に推移しました。一方で、PC関連製品は伸び悩みました。

以上の結果、当部門の売上高は245,519百万円(前期比2.3%減)営業利益は101百万円となりました。

連結売上高推移



連結営業利益推移



液晶プロジェクター用光学部品

貸借対照表

科 目	当年度 (平成15年3月31日現在)	前年度 (平成14年3月31日現在)
(資産の部)	百万円	百万円
流動資産	289,186	274,386
現金及び預金	51,675	43,193
受取手形及び売掛金	181,469	177,127
有価証券	2,164	2,098
たな卸資産	37,741	37,448
繰延税金資産	10,652	8,036
前渡金	2,444	2,917
その他の貸倒引当金	4,665	5,663
	1,623	2,095
固定資産	100,518	108,147
有形固定資産	57,099	56,584
建物及び構築物	21,170	19,436
機械装置及び運搬具	7,709	8,854
工具器具備品	6,624	6,616
土地	21,347	20,842
建設仮勘定	250	836
無形固定資産	4,051	3,187
営業権及び特許権	1,087	1,371
ソフトウェア	2,760	1,574
その他の投資	204	241
その他の資産	39,368	48,376
投資有価証券	21,601	31,328
長期貸付金	1,630	1,817
その他の繰延税金資産	7,737	8,523
貸倒引当金	9,600	8,137
	1,200	1,429
資産合計	389,704	382,533

科 目	当年度 (平成15年3月31日現在)	前年度 (平成14年3月31日現在)
(負債の部)	百万円	百万円
流動負債	205,105	199,766
支払手形及び買掛金	141,356	129,371
短期借入金	20,766	29,425
未払法人税等	5,898	2,805
未払費用	20,465	19,416
前受金	8,755	9,579
その他の負債	7,865	9,172
固定負債	25,111	24,566
退職給付引当金	23,524	23,283
役員退職慰労引当金	1,466	1,157
その他の負債	121	126
負債合計	230,216	224,332
(少数株主持分)		
少数株主持分	4,327	3,047
(資本の部)		
資本	7,938	7,938
資本剰余金	35,745	35,723
利益剰余金	109,633	106,733
その他の有価証券評価差額金	2,923	4,581
為替換算調整勘定	853	290
自己株式	226	111
資本合計	155,161	155,154
負債、少数株主持分及び資本合計	389,704	382,533

損益計算書

科 目	当年度 (平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)	前年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)
	百万円	百万円
売上高	778,229	738,289
売上原価	684,007	662,257
売上総利益	94,222	76,032
販売費及び一般管理費	82,378	66,092
営業利益	11,844	9,940
営業外収益	2,794	2,268
受取利息	676	1,047
受取配当金	145	160
持分法による投資利益	70	159
雑収益	1,903	902
営業外費用	2,533	1,887
支払利息	208	183
雑損失	2,325	1,703
経常利益	12,104	10,321
特別利益		
特別損失		
税金等調整前当期純利益	12,104	10,321
法人税、住民税及び事業税	8,645	4,574
法人税等調整額	2,856	108
少数株主利益	388	132
当期純利益	5,928	5,507

当年度の注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法は以下によります。

その他有価証券

時価のあるもの... 連結決算日の市場価格等に基づく時価法、売却原価は移動平均法により算定(評価差額は全部資本直入法により処理)

時価のないもの... 移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法は以下によります。

商 品.....主として移動平均法による原価法

製品・半製品・材料.....主として移動平均法による低価法

仕 掛 品.....主として個別法による低価法

3. 有形固定資産の減価償却の方法は、主として定率法、但し、レンタル資産はレンタル期間に応じた定額法によっております。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法によっております。また、平成13年10月1日付で吸収分割により承継した建物については、定額法によっております。

有形固定資産の減価償却累計額 57,704百万円

4. 貸倒引当金は、主として一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

5. 退職給付引当金は、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

6. 役員退職慰労引当金については、役員退職慰労金規則に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

7. リース取引の処理方法は、当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、在外連結子会社については主として通常の売買取引に準じた会計処理によっております。

8. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

9. 保証債務 1,918百万円

10. 輸出手形割引高 1,242百万円

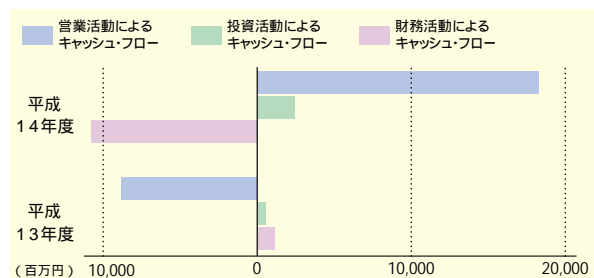
11. 受取手形裏書譲渡高 226百万円

12. 自己株式 153,800株

キャッシュ・フロー計算書

科 目	当年度 (平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)	前年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)
	百万円	百万円
税金等調整前当期純利益	12,104	10,321
減価償却費	7,458	4,882
売上債権の増減額	4,530	47,784
仕入債権の増減額	610	3,732
仕入債務の増減額	10,080	68,691
法人税等の支払額	5,517	9,898
その他	702	3,047
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,284	8,824
有形・無形固定資産の取得による支出	6,383	5,204
有形・無形固定資産の売却による収入	852	56
その他	7,988	5,694
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,457	547
短期借入金の純増減額	8,652	3,450
配当金の支払額	2,065	2,193
その他	101	117
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,818	1,139
現金及び現金同等物に係る換算差額	612	1,379
現金及び現金同等物の増減額	9,311	5,759
現金及び現金同等物の期首残高	42,811	42,995
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	334	3,814
吸収分割による連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,759
現金及び現金同等物の期末残高	52,456	42,811

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書の は、現金及び現金同等物の流出を示しております。



営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、18,284百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益12,104百万円、減価償却費7,458百万円、仕入債務の増加額10,080百万円による増加と、法人税等の支払額5,517百万円、売上債権の増加額4,530百万円の減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,457百万円の増加となりました。これは主に、デモセンターである「サイエンスラボドリ」やヨーロッパ日立ハイテクノロジーズGmbHの新社屋建設等の有形固定資産の取得による支出5,510百万円、当社新ERPシステム構築等の無形固定資産の取得による支出873百万円があったものの、運用債券の償還及び株式の売却7,760百万円、貸付金の回収2,070百万円等の収入があったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、10,818百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出8,652百万円、配当金の支払による支出2,065百万円によるものです。

グループ会社一覧 (平成15年3月31日現在)

当社の連結対象会社は下記のとおり36社であります。

重要な連結子会社

会社名	資本金	主な事業内容
日立計測器サービス株式会社	1,000百万円	科学機器・工業計器等の据付保守サービス
株式会社日立製エレクトロニクス	300百万円	情報機器・電子部品等の販売
株式会社日立メックス	200百万円	化学製品・電子材料等の販売
日立エンジニアリング株式会社	100百万円	計装・FAに関するエンジニアリング機器の販売
株式会社日立サイエンスシステムズ	400百万円	汎用科学機器・小形医用機器の製造及びソフトウェアの開発・製作、関連する技術を用いた受託分析
日立那珂エレクトロニクス株式会社	200百万円	計測制御システム・計測制御機器・検体検査システムの製造、那珂事業所関連製品の原料・部品製作
那珂インスツルメンツ株式会社	180百万円	分析装置・医用機器用ユニットの製造、精密金型及び成形品の生産
アメリカ日立ハイテクノロジーズInc.	15,000千米ドル	電子部品・情報機器・科学機器等の販売
ヨーロッパ日立ハイテクノロジーズGmbH	2,556千ユーロ	情報機器・科学機器・電子部品等の販売
シンガポール日立ハイテクノロジーズPte. Ltd.	4,000千シンガポールドル	電子部品・産業機械・工業材料等の販売
香港日立ハイテクノロジーズ有限公司	15,000千香港ドル	産業機械・情報機器・電子部品・工業材料等の販売

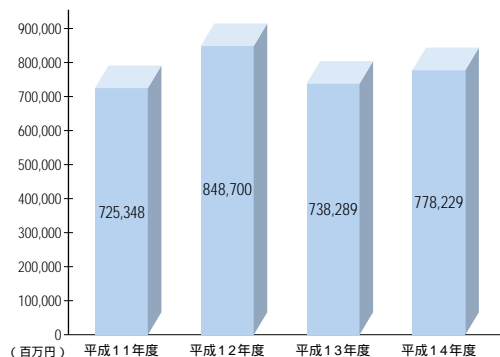
その他の連結子会社

日立ソフトウェア株式会社
 日立サービス株式会社
 株式会社日立サイエンス
 日立電機株式会社
 株式会社テラウイン
 ギーゼック・アンド・デブリエント株式会社
 株式会社オムニカルテ社
 ヒスコソリューション株式会社
 計測テクノロジーズ株式会社
 カナダ日立ハイテクノロジーズInc.
 ブラジル日立ハイテクノロジーズLtda.
 フランス日立ハイテクノロジーズS.A.R.L.
 ヨーロッパヒスコ GmbH.
 HIIサイエンティフィックインスツルメンツLtd.
 HHTAセミコンダクターイクイップメントLtd.
 アイルランド日立ハイテクノロジーズLimited.
 マレーシア日立ハイテクノロジーズIPC Sdn.Bhd.
 タイランド日立ハイテクノロジーズLtd.
 日製三洋ハイテクサービスPte.Ltd.
 日製産業貿易(深圳)有限公司
 上海日立ハイテクノロジーズ有限公司
 韓国ヒスコLtd.
 亞太日立計測器服務股份有限公司
 日速科計測器(上海)有限公司
 日立儀器(蘇州)有限公司

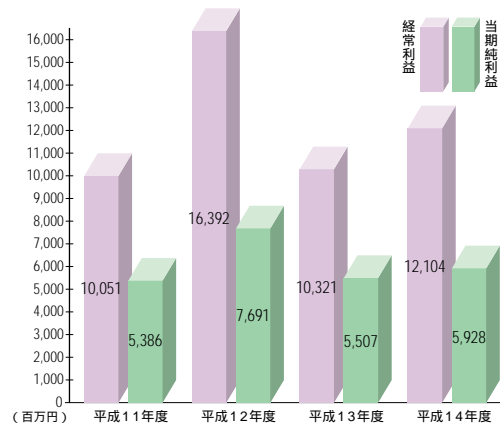
経営指標の推移

科 目	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度
経営成績				
連結売上高 (百万円)	725,348	848,700	738,289	778,229
連結経常利益 (百万円)	10,051	16,392	10,321	12,104
連結当期純利益 (百万円)	5,386	7,691	5,507	5,928
連結1株当たり当期純利益 (円)	60.49	87.66	49.71	40.92
連結株主資本当期純利益率(%)	5.3	6.9	4.0	3.8
連結売上高経常利益率(%)	1.4	1.9	1.4	1.6
財政状態				
連結総資産 (百万円)	305,483	354,895	382,533	389,704
連結株主資本 (百万円)	106,173	117,220	155,154	155,161
連結株主資本比率(%)	34.8	33.0	40.6	39.8
連結1株当たり株主資本 (円)	1,210.15	1,336.04	1,127.04	1,125.60

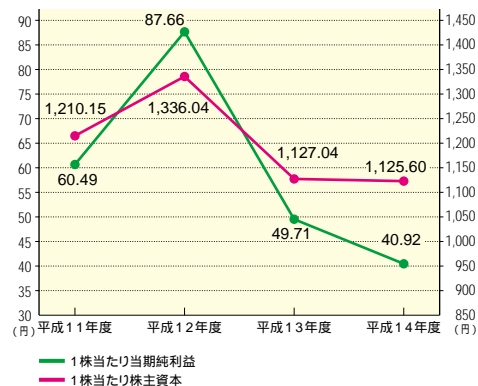
売上高



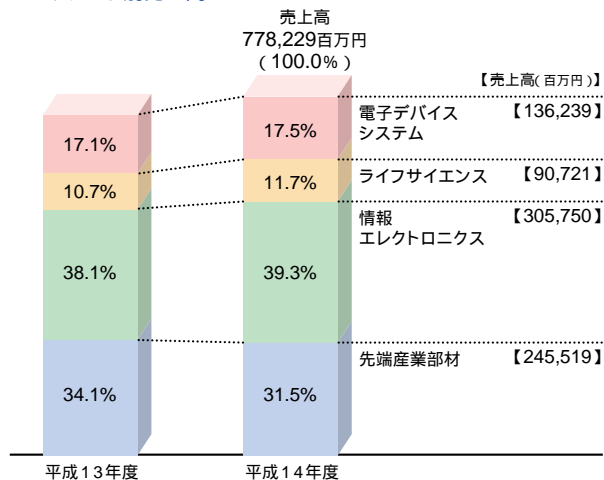
経常利益・当期純利益



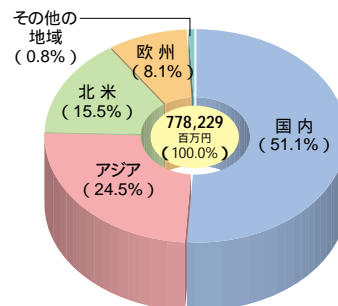
1株当たり当期純利益・1株当たり株主資本



セグメント別売上高



仕向地別売上高 (平成14年度)



貸借対照表

科 目	当年度	前年度
	(平成15年3月31日現在)	(平成14年3月31日現在)
(資産の部)	百万円	百万円
流 動 資 産	199,662	190,090
現金及び預金	25,623	16,237
受取手形	10,449	11,811
売掛金	127,888	124,949
有価証券	2,100	2,005
商 品	4,724	6,985
製 品	3,474	3,241
半 導 体	223	414
材 料	1,337	1,493
仕 掛 品	10,548	11,170
前 渡 金	2,169	2,790
繰延税金資産	5,217	3,637
その他の流動資産	6,965	6,711
貸倒引当金	1,060	1,358
固 定 資 産	84,339	92,159
有形固定資産	44,432	45,839
建築物	14,884	14,661
構築物	429	481
機械装置	5,889	7,678
車輜運搬具	16	19
工具器具備品	4,143	4,537
土地	18,964	18,424
建設仮勘定	104	36
無形固定資産	3,075	2,369
営業権	903	1,184
特許権	49	83
ソフトウェア	2,024	959
施設利用権	65	66
その他の無形固定資産	32	76
投 資 等	36,831	43,951
子会社株式及び出資金	7,856	6,071
投資有価証券	18,599	28,024
長期貸付金	1,302	1,511
敷金保証金	1,586	1,694
繰延税金資産	4,760	3,584
その他の投資等	3,878	4,441
貸倒引当金	1,151	1,376
資 産 合 計	284,002	282,249

当年度の注記

- 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 有価証券の評価基準及び評価方法は以下によっております。
子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法、評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定
時価のないもの…移動平均法による原価法
- たな卸資産の評価基準及び評価方法は以下によっております。
商 品……………移動平均法による原価法
製品・半製品・材料……移動平均法による低価法
仕 掛 品……………個別法による低価法
- 有形固定資産の減価償却の方法は定率法、但し、レンタル資産は定額法によっております。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法によっております。また、平成13年10月1日付で吸収分割により承継した建物については、定額法によっております。
有形固定資産の減価償却累計額 45,779百万円

科 目	当年度	前年度
	(平成15年3月31日現在)	(平成14年3月31日現在)
(負債の部)	百万円	百万円
流 動 負 債	148,966	146,633
支払手形	14,722	19,261
買掛金	96,478	82,089
短期借入金	10,000	20,000
未払金	2,210	3,015
未払税金	2,466	100
未払費用	12,654	10,284
前受金	5,972	6,972
その他の流動負債	4,460	4,909
固 定 負 債	13,884	14,110
退職給付引当金	13,212	13,567
役員退職慰労引当金	671	543
負 債 合 計	162,850	160,743
(資本の部)		
資 本 金	7,938	7,938
資本剰余金	35,744	35,723
利益剰余金	74,817	73,438
利益準備金	1,359	1,359
別途積立金	68,800	66,500
当期末処分利益	4,657	5,578
(うち当期利益)	(3,544)	(3,313)
株主等評価差額金	2,876	4,517
自己株式	225	111
資 本 合 計	121,151	121,506
負 債 及 び 資 本 合 計	284,002	282,249

- リース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- 退職給付引当金は、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- 役員退職慰労引当金については、商法第287条ノ2に規定する引当金であります。
- 商法第290条第1項第6号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は2,876百万円であります。
- 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
- 親会社短期金銭債権 11,164百万円
- 親会社短期金銭債務 20,842百万円
- 子会社短期金銭債権 27,546百万円
- 子会社短期金銭債務 15,549百万円
- 保証債務 1,752百万円
- 輸出手形割引高 9,468百万円
- 受取手形裏書譲渡高 103百万円
- 1株当たり当期利益 25円02銭

損益計算書

科 目	当年度 (平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)	前年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)
(経常損益の部)	百万円	百万円
営業損益の部		
売上高	557,976	511,160
売上原価	497,374	462,430
販売費及び一般管理費	55,684	43,962
営業利益	4,917	4,768
営業外損益の部		
営業外収益	4,095	2,469
受取配当金	456	604
受取配当金	1,856	1,084
雑収益	1,782	780
営業外費用	2,397	1,517
支払利息	164	140
雑損失	2,232	1,376
経常利益	6,616	5,720
(特別損益の部)		
特別損失		
税引前当期利益	6,616	5,720
法人税、住民税及び事業税	4,527	2,039
法人税等調整額	1,455	368
当期繰越利益	3,544	3,313
中間配当額	2,146	2,923
当期末処分利益	1,032	658
	4,657	5,578

当年度の注記

親会社との取引高

売上高	78,281百万円
仕入高	62,591百万円
営業取引以外の取引高	8,926百万円

子会社との取引高

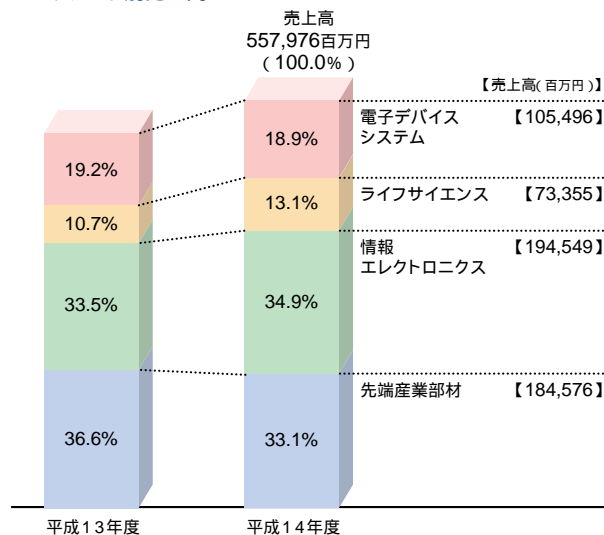
売上高	121,766百万円
仕入高	78,799百万円
営業取引以外の取引高	11,836百万円

利益処分

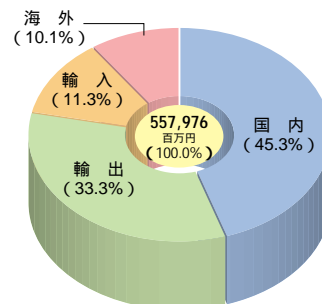
当期末処分利益	円
これを下記のとおり処分します。	4,657,517,229
利益配当金	1,031,886,975
1株につき7円50銭 (普通配当7円50銭)	
取締役賞与金	100,000,000
別途積立金	1,400,000,000
次期繰越利益	2,125,630,254

- (注) 1. 平成14年12月2日に1株につき7円50銭の中間配当を実施しました。
2. 利益配当金は自己株式153,800株分を除いております。

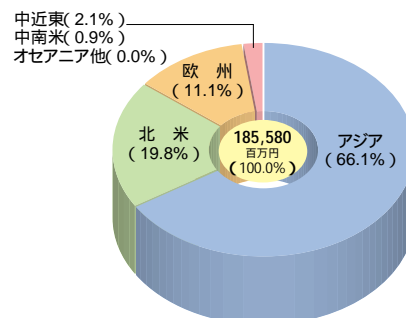
セグメント別売上高



取引形態別売上高 (平成14年度)



地域別輸出売上高 (平成14年度)



経営指標の推移

科 目	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度
経営成績				
売上高 (百万円)	539,217	579,738	511,160	557,976
経常利益 (百万円)	7,711	10,540	5,720	6,616
当期利益 (百万円)	4,366	5,562	3,313	3,544
1株当たり当期利益 (円)	49.03	63.40	29.91	25.02
株主資本当期利益率 (%)	5.3	6.2	3.1	2.9
売上高経常利益率 (%)	1.4	1.8	1.1	1.2
財政状態				
総資産 (百万円)	231,362	257,958	282,249	284,002
株主資本 (百万円)	84,481	94,130	121,506	121,151
株主資本比率 (%)	36.5	36.5	43.0	42.7
1株当たり株主資本 (円)	962.88	1,072.85	882.62	879.83
資本金 (百万円)	5,438	5,438	7,938	7,938
発行済株式総数 (千株)	87,739	87,739	137,739	137,739
配当状況				
1株当たり年間配当金 (円)	25.00	30.00	15.00	15.00
配当性向 (%)	50.6	47.3	51.0	60.0
その他従業員数 (人)	1,388	1,375	3,130	3,036

平成12年度

当年度における世界経済は、2000年後半に入り、これまで世界経済を牽引してきた米国経済の成長鈍化が明らかになったものの、欧州、アジア経済は低水準ながらも比較的堅調に推移しました。また、日本経済は、移動体通信やデジタル家電等IT関連を中心に民間設備投資の一部に活発な動きが見られましたが、依然として雇用環境は厳しく、個人消費は低迷した状況が続きました。

このような経営環境の中にあって当社は、半導体や情報通信等の成長分野に経営資源を集中投入すると共に、競争力ある新規事業の開発を推進して参りました。

この結果、当年度の業績は前年度比較で、売上高7.5%増、営業利益50.1%増、経常利益36.7%増、当期純利益27.4%増となり、売上高、収益共に前年度を上回り、特に営業利益、当期利益は過去最高となりました。

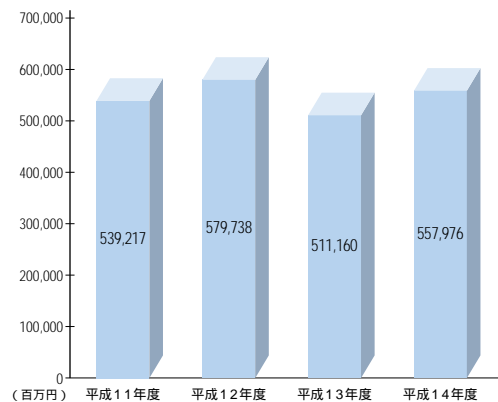
平成13年度

当年度の経営環境は、世界的なIT不況に伴い、日本をはじめ、欧米、アジア各国において景気減速が同時に進行する等、非常に厳しい状況で推移致しました。

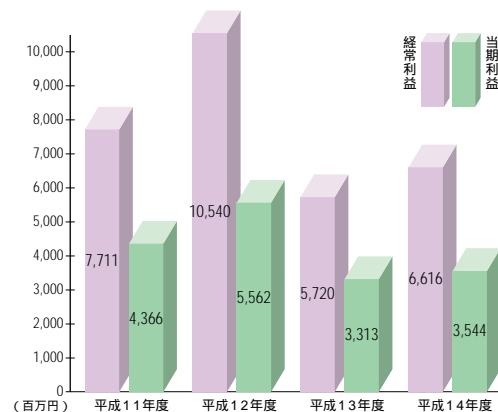
このような環境の中、当社は成長事業分野への経営資源の集中と、競争力ある新製品、及び新規事業の開発を進めて参りましたものの、半導体や情報通信分野の設備投資抑制等の影響により、半導体製造装置や光通信用部品の業績が大幅に低迷致しました。

この結果、当年度の業績は、前年度比較で、売上高11.8%減、営業利益49.7%減、経常利益45.7%減、当期利益40.4%減となりました。

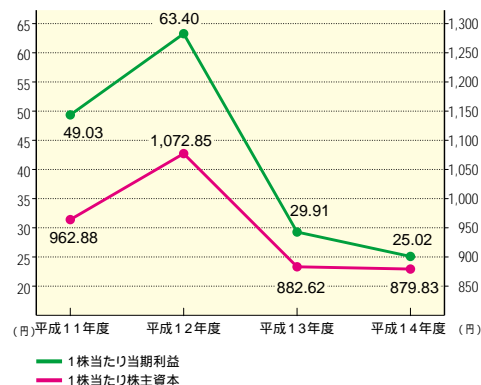
売上高



経常利益・当期利益



1株当たり当期利益・1株当たり株主資本

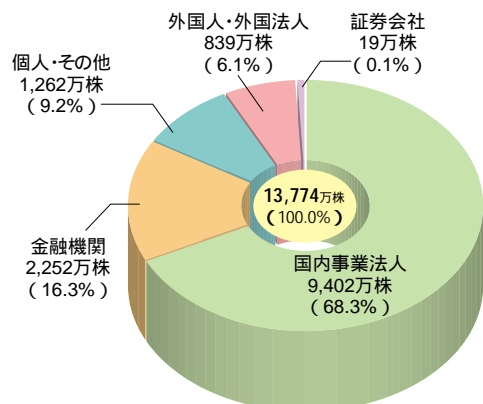


株式の状況

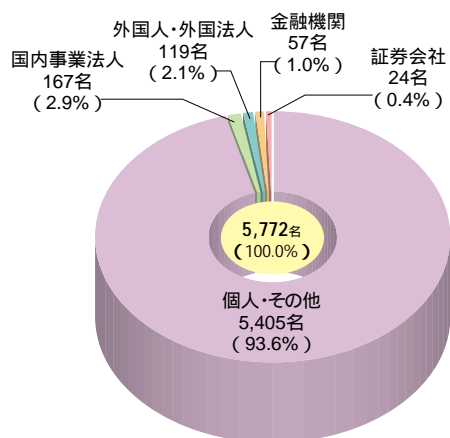
株式の状況（平成15年3月31日現在）

発行済株式総数	137,738,730株
株主数	5,772名
当年度株式移動状況	
名義書換件数	598件
名義書換株式数	11,121,072株

株式分布状況（平成15年3月31日現在）



所有者別株式分布状況(株数)

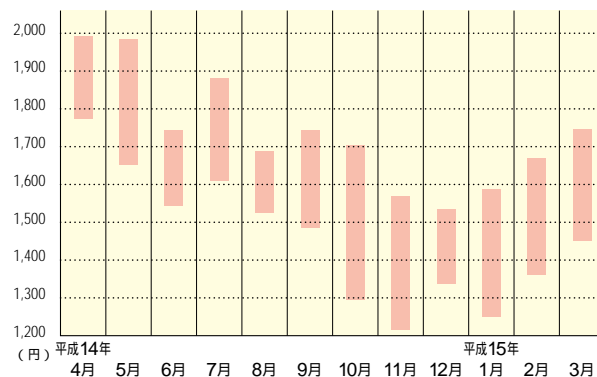


所有者別株式分布状況(株主数)

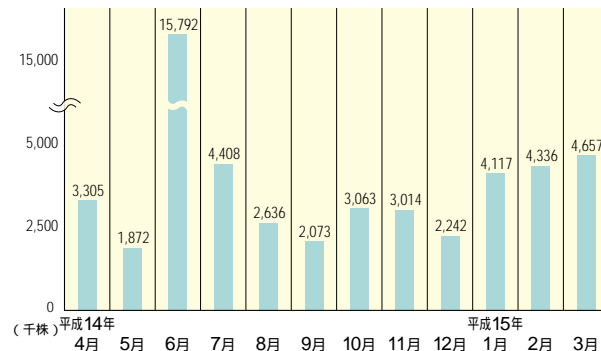
大株主（平成15年3月31日現在）

株主名	持株数	持株比率
株式会社日立製作所	91,807,382株	66.7%
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社	6,176,000株	4.5%
三井アセット信託銀行株式会社	3,467,000株	2.5%
資産管理サービス 信託銀行株式会社	2,909,000株	2.1%
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社	2,629,000株	1.9%
日立ハイテクノロジーズ社員持株会	2,373,636株	1.7%
ザチェースマンハッタンバンク	2,177,000株	1.6%
株式会社みずほ銀行	2,173,042株	1.6%
UFJ信託銀行株式会社	1,460,624株	1.1%
リンクス	731,000株	0.5%

当社株価の推移（東京証券取引所における市場相場）



売高の推移（東京証券取引所）



国内事業所

本社

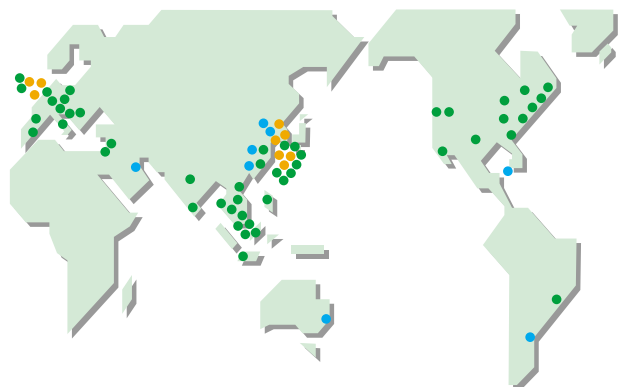
〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号

事業所及び支店

那珂事業所、笠戸事業所、北海道支店、東北支店、
茨城支店、筑波支店、中部支店、関西支店、
中国支店、九州支店

営業所及び出張所

北陸営業所、高崎営業所、横浜営業所、
栃木営業所、豊田営業所、浜松営業所、
京都営業所、四国営業所、南九州営業所、
茂原出張所



海外事業所

支店

ロンドン支店、台北支店、ソウル支店

出張所

ハバナ出張所、プエノスアイレス出張所、クウェート出張所、北京出張所、
上海出張所、広州出張所、大連出張所、シドニー出張所

海外グループ会社

株主メモ

決算期	毎年3月末日
定時株主総会	毎年6月
公告掲載新聞	日本経済新聞
決算公告掲載ホームページアドレス	http://www.hitachi-hitec.com/
配当金受領株主確定日	利益配当金 毎年3月末日 中間配当金 毎年9月末日
名義書換代理人	東京証券代行株式会社
同上事務取扱場所	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 (新丸ビル7階) 電話(03)3212-4611(代表)


単元未満株式買取請求

単元未満株式の買取請求は、上記名義書換代理人において受付けております。

株券喪失登録

株券を紛失された方は、上記名義書換代理人において株券喪失登録の手続を行うことができます。株券喪失登録を行いますと、株券喪失登録簿に喪失株券の記号番号等が登録されて閲覧に供され、1年間登録異議もしくは喪失登録の抹消がなければ、当該株券は失効し、新しい株券の交付を受けることができます。株券喪失登録に要する費用は、1件10,000円に加えて喪失登録株券1枚につき500円です。

上場証券取引所 東京・大阪証券取引所(市場第一部)



咲きます。
ハイテクソリューション。

「日立ハイテクノロジーズ」は、ナノテクなどの最先端テクノロジーを駆使する設計・製造機能と、グローバルな最先端ソリューションサービスを提供する商社機能をインテグレートしたハイテク創造企業。半導体製造分野のナノスケール加工・観察・評価・解析ソリューション、バイオ・臨床診断分野の分析・解析ソリューション、コンシューマ・産業分野のIT高付加価値ソリューション、先端産業部材のグローバル調達・開発ソリューションなど、幅広いビジネスフィールドで、21世紀のハイテク・ソリューションの花を咲かせます。

◎ 株式会社日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号 電話:(03)3504-7111
<http://www.hitachi-hitec.com/>

事業所数:世界24ヵ国 国内事業所 21ヵ所 海外事業所 75ヵ所

事業分野:デバイス製造装置/ライフサイエンス/情報・生産/電子部品/先端産業部材